

제우스 (079370)

신규장비에 대한 기대감이 개화될 시점

제우스는 반도체/디스플레이 장비 제조 기업이다. 세정장비, 열장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 로봇 등을 제조 판매하고 있다. 2021년 이후로는 반도체 제조장비가 주력 제품이며, 전체 매출액의 60%를 상회하고 있다. 2H25부터 동사의 신규장비 개화시점에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상, 주목이 필요한 시점이라고 판단한다.

포토닉 디본딩 자동화 장비

동사가 美 펄스포지사와 포토닉 자동화 장비 개발을 위해 협업을 진행하고 있다. 포토닉 디본딩은 플래시램프를 이용해 LAL(Light Absorb Layer)에 선택적으로 광을 조사하여 캐리어 웨이퍼를 분리하는 기술이다. 웨이퍼에 물리적·화학적 충격이 발생하지 않아 웨이퍼 손상 및 변형의 위험을 최소화할 수 있다. 불필요한 잔여물 생성을 억제하여 제조 공정의 안정성을 향상시킬 수 있다. 즉, 타 디본딩 방식의 단점을 해결할 수 있는 방식이라는 점에서 주목을 받고 있다. 국내외 기업과 협업을 진행하고 있다. 국내외 반도체 IDM사들이 내년에 신규 Fab을 구축할 예정이라는 점을 고려시 연내 수주-내년 양산으로 진행될 가능성이 높다고 예상된다.

산업용 로봇

로봇 관련 저전압 모터, 드라이버, 모션 알고리즘 기술을 보유하고 있으며, 회로 설계부터 펌웨어까지 자체 기술로 구현 가능하다. 이러한 기술을 바탕으로 관절로봇, AMR 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있다. 기존 디스플레이 반송로봇에서 다양한 산업으로 확대가 진행 중이다. 지난 5월 대기업에 모바일 매니플레이터 플랫폼을 활용한 로봇 시스템 수주에 성공했다고 밝혔으며, 향후 2차전지 기업으로의 진출도 모색하고 있다.

PEP

산자부 주관의 정부과제(2023.07~2026.12)를 통해 PEP(Pressurized Etch Process, 가압식 식각공정) 개발을 진행하고 있다. 세미콘코리아 2025(2025.2월)에서 동사는 PEP 세정장비를 공개했으며, 26년까지 R&D를 진행한 이후 27년 이후 양산이 시작될 수 있다.

Forecasts and valuations (K-IFRS 연결)

(억원, 원, %, 배)

결산 (12월)	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액	4,008	5,090	4,029	4,908
영업이익	249	463	71	492
지배순이익	160	350	99	419
PER	16.2	7.7	36.4	11.7
PBR	1.0	1.0	1.2	1.4
EV/EBITDA	8.1	5.2	21.0	8.0
ROE	6.6	13.4	3.4	13.0

자료: 유안타증권



권명준 스몰캡
myoungchun.kwon@yuantakorea.com

서석준 Research Assistant
seokjun.seo@yuantakorea.com

NOT RATED (I)

목표주가 -원 (I)

직전 목표주가 -원

현재주가 (09/17) 13,880원

상승여력 -

시가총액	4,305억원
총발행주식수	31,016,990주
60일 평균 거래대금	15억원
60일 평균 거래량	120,054주
52주 고/저	16,020원 / 10,240원
외인지분율	5.21%
배당수익률	0.00%
주요주주	이종우 외 5인

주가수익률 (%)	1개월	3개월	12개월
절대	13.0	6.9	4.8
상대	9.0	(1.9)	(9.1)
절대 (달러환산)	13.2	5.6	1.0

금융투자분석사의 확인 및 중요 공시는 Appendix 참조

회사개요

제우스는 반도체 및 디스플레이 관련 장비 제조 및 판매 기업이다. 1970년에 설립되었으며 2006년에 코스닥에 상장되었다. 상장 자회사로는 J.E.T가 있다. 2009년에 인수한 일본 자회사로, 2023년 일본에 상장되었다.

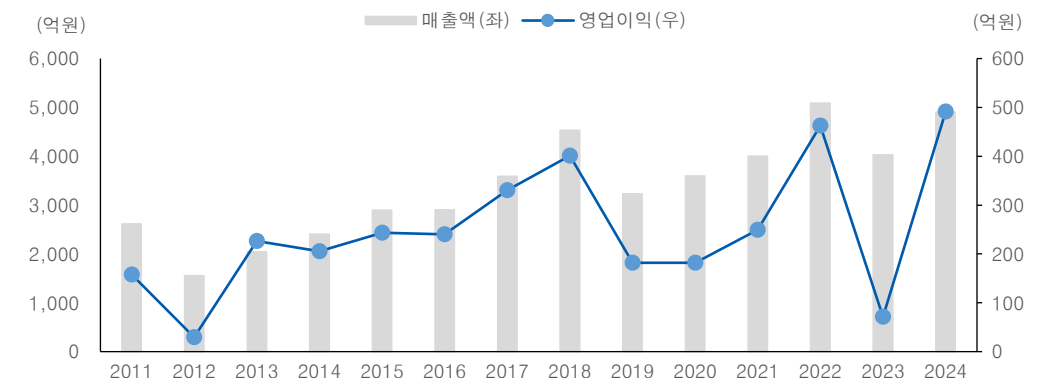
주요사업을 산업별로 구분하면 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 로봇 등을 제조 판매하고 있다. 전방산업에 따라 실적이 변동되는 경향을 확인할 수 있다. 2021년 이후로는 반도체 제조장비가 주력 제품이며, 전체 매출액의 60%를 상회하고 있다.

상반기 부진한 실적을 기록했다. 1H25 실적은 매출액 1,977.3억원, 영업이익 2.7억원으로 전년 대비 각각 9.7%, 98.4% 감소했다. 수익성 부진의 주요 원인은 일본 자회사 J.E.T에 있다. 1H25 매출액 670.3억원, 당기순이익 -212.0억원에 달했다. J.E.T는 배치형 세정장비를 납품하는 기업으로 국내 기업향으로 공급할 장비의 도입이 늦어지면서 부진한 실적을 기록했다.

수주잔고 추이도 부진한 상황이다. 수주와 실적의 상관관계가 1은 아니지만 4Q23이후로 꾸준히 하락하고 있다는 점에서 올해 하반기에도 매출액 기준으로 큰 폭의 개선을 기대하기 어려운 상황이다.

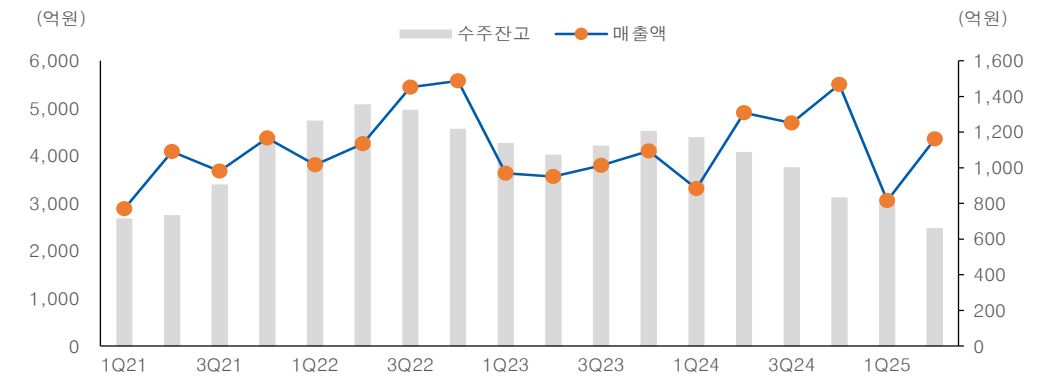
장비 기업은 신규 장비의 도입 여부 및 도입 시점에 주목을 받는다. 동사는 2020년 이후 연구 개발비용으로 연간 200억원 넘는 비용을 투자하고 있다. 2H25부터 신규장비에 대한 기대감이 높아지는 시점이라고 판단, 동사에 대한 관심이 필요한 시기이다.

[차트 1] 연도별 매출액과 영업이익 추이



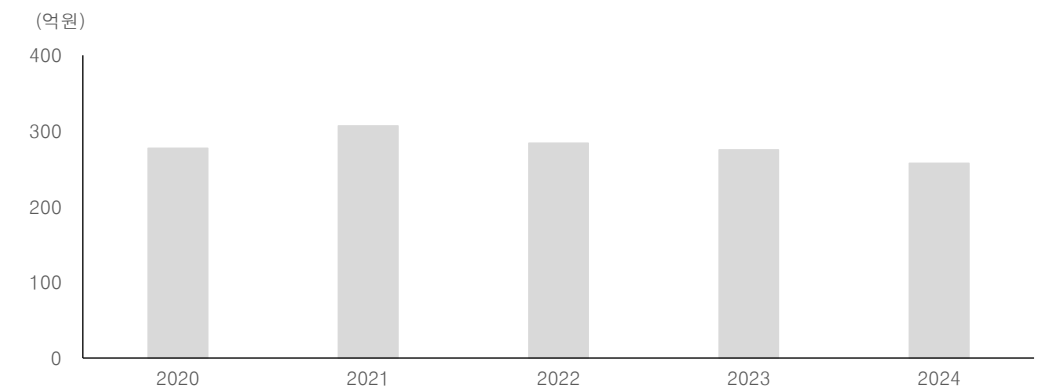
자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

[차트 2] 수주잔고 추이



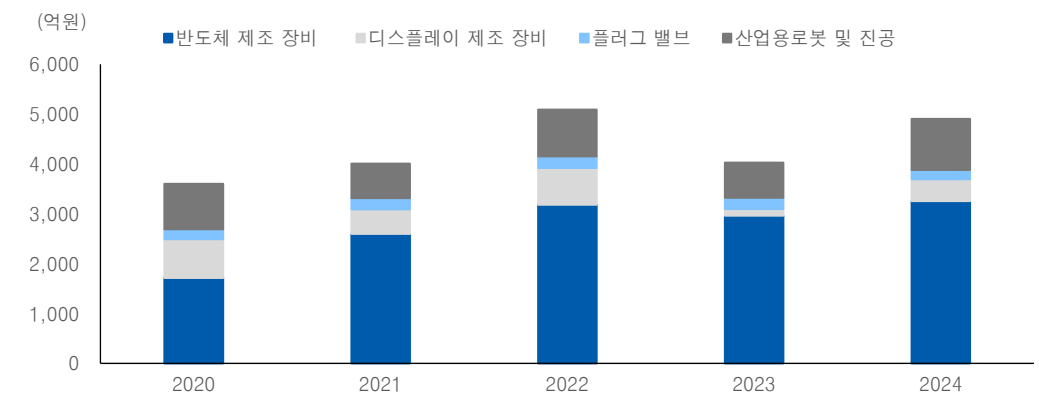
자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

[차트 3] 연구개발비용 추이



자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

[차트 4] 사업부별 매출액 추이



자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

반도체 세정장비

동사는 반도체 습식 세정기를 생산 및 판매하고 있다. 2010년 대형 반도체 제조 고객사의 DRAM 공정, 2011년에는 NAND 공정내 적용을 시작하여 현재까지 이어오고 있다.

반도체 세정장비는 다양한 공정에 사용된다. 세정장비의 목적은 파티클 제거, 유기물 제거, 금속 이온 제거, 산화막 제거/박리 등에 있다. 파티클 제거용 세정장비는 포토공정, 식각공정, CMP 이후에 사용된다. 유기물 제거 세정은 포토레지스트 공정, CVD/ALD 증착 이전에 사용된다. 금속 이온 제거용 세정장비는 식각/증착 이후와 Diffusion/Ion Implantation 이후에 적용된다. 산화막 제거용 세정장비는 식각/증착 전, Ion Implantation전에 사용된다. 즉 포토공정, 식각공정, 증착공정, 이온주입공정 등의 반도체 주요 공정 전후에 사용된다.

세정방식. 반도체 세정장비를 방식별로 구분하면 습식 세정과 건식 세정 방식이 있다. 습식 세정방식은 화학용액과 순수/초순수를 사용하여 오염물을 제거하는 방식이다. 대량 처리가 가능하며 공정비용이 낮다는 장점을 보유하고 있다. 하지만 화학약품 사용량이 많아 환경오염물질을 배출하며 미세 패턴 손상 가능성이 존재한다는 단점을 보유하고 있다.

건식 세정은 플라즈마 등을 사용하여 물리적, 화학적 반응을 건조한 환경에서 유도하여 오염물을 제거하는 방식이다. 화학물질 사용량이 적어 상대적으로 친환경적이며, 초미세 공정에서 파티클 제어 및 패턴 손상을 최소화한다는 장점이 있다. 하지만 처리 속도가 느리며, 공정 난이도가 높아 장비가격이 비싸다는 단점이 있다. 건식 세정의 종류로는 Plasma Ashing, UV/Ozone Cleaning, CO2 Snow Cleaning, Laser Clearing 등이 있다.

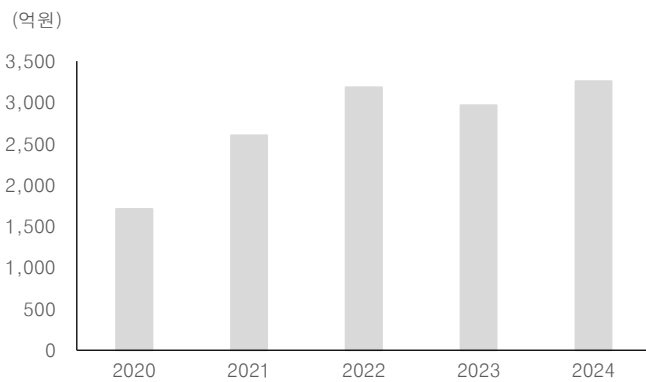
북미 및 유럽에서 환경 규제 이슈가 부각됨에 따라 건식 세정에 대한 필요성이 확대되고 있지만, 국내 메모리 반도체 기업의 특성인 소품종 대량생산에서는 습식 세정방식이 여전히 유효한 상황이다. 차세대 미세공정(FinFET, GAA 등) 일부에서는 건식 세정방식이 우선적으로 도입되어 활용될 수 있다고 판단된다.

세정형태. 동사가 사업을 영위하는 습식 세정방식의 세정형태별로는 배치형(Batch type)과 단일 웨이퍼형(Single wafer type, 매엽식)으로 구분된다. 배치형은 다수의 웨이퍼를 한번에 세정할 수 있어 처리 속도가 빠르다는 장점을 보유하고 있다. 하지만 여러 장의 웨이퍼를 동시에 처리하는 공정 하에서 A장에서 발생한 파티클이 B웨이퍼로 이동 및 오염시킬 가능성이 존재하며 웨이퍼 위치에 따라 세정의 균일도가 다르다는 특징이 있다. 즉, 미세공정화 될수록 미세 파티클로 인해 수율이 악화될 수 있다는 점에서 한계점이 존재한다.

매엽식 세정장비는 웨이퍼 한장씩 세정하는 방식이다. 한장씩 세정을 하기 때문에 생산속도가 배치형 대비 늦다는 단점이 있다. 하지만, 균일한 세정이 가능하며 미세한 파티클 제어가 가능하여 수율을 향상시키는 장점이 있다. 필요한 구역에 지역적으로 화학물질을 처리하기 때문에 환경물질 배출이 축소된다는 특징도 있다. Regacy 반도체는 배치형 타입의 세정장비, 미세공정에서는 단일 웨이퍼형인 매엽식 방식이 주로 사용될 가능성이 높다.

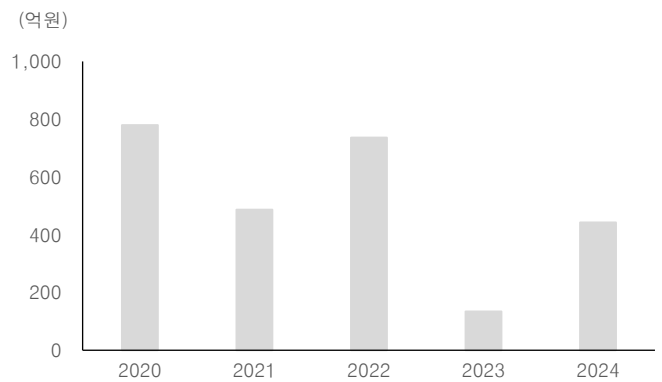
2024년 전년대비 실적 성장을 견인한 장비도 세정장비이다. HBM 패키징 공정용 세정장비로 TSV 공정 이후 진행되는 세정공정에 적용된다. 국내 주요 고객사에 공급했다. HBM에 대한 수요가 확대됨에 따라 메모리반도체 기업들의 HBM 관련 투자가 확대될 것으로 기대, 이에 따른 실적개선이 기대된다. 국내 고객사 위주의 Biz에서 해외 고객사로의 진출도 모색 중이다. 국내에서 수년 제품을 납품 및 안정적으로 운영하고 있는 레퍼런스를 기반으로 해외기업과의 진출을 시도하고 있다.

[차트 5] 반도체 사업부 매출액 추이



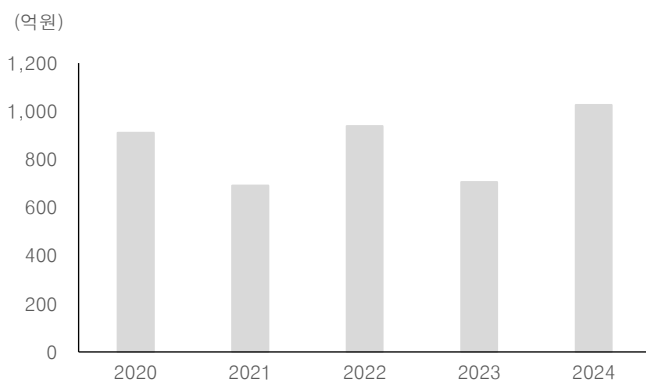
자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

[차트 6] 디스플레이 사업부 매출액 추이



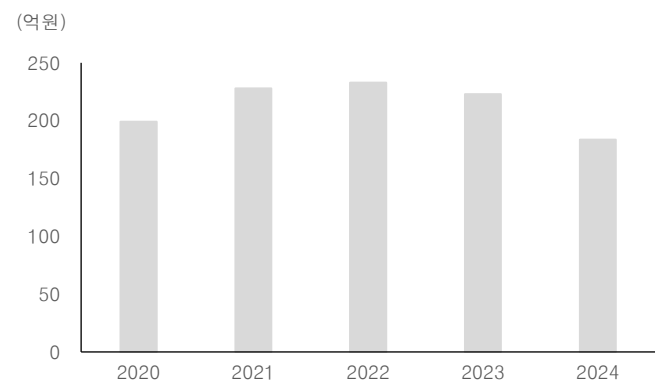
자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

[차트 7] 산업용 로봇 및 진공 사업부 매출액 추이



자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

[차트 8] 플러그 밸브 사업부 매출액 추이



자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

성장동력1. 포토닉 디본딩 자동화 장비

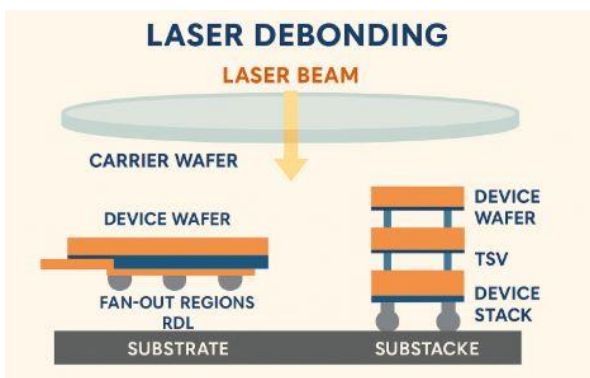
디본딩 공정은 임시 접착된 웨이퍼를 분리하는 공정이다. 반도체 기술이 발전과 더불어 웨이퍼 두께는 얇아지고 있다. 하지만, 얇은 웨이퍼는 공정 중 휘어지거나 파손될 위험이 높다. 이러한 문제를 해결하기 위해 캐리어 웨이퍼(지지대 역할)에 웨이퍼를 임시로 접착하여 공정을 진행, 완료 이후 캐리어 웨이퍼를 분리하는 공정이다. 디본딩 이후 웨이퍼 표면에 접착제 잔여물이 남지 않아야 하며, 웨이퍼의 손상이 없어야 한다.

디본딩은 접착방식과 분리방식에 따라 다음과 같이 구분된다. 첫째, 기계적 디본딩이다. 물리적인 힘(압은 휠)을 가하여 접착된 웨이퍼를 분리하는 방식이다. 단순한 방식이지만, 웨이퍼 손상 가능성이 높으며, 균일하게 분리하는데 어려움이 있다. 둘째, 열적 디본딩이다. 열을 가하여 접착층의 특성을 변화시키거나, 접착력을 약화시켜 웨이퍼를 분리하는 방식이다. 제어가 용이하다는 장점이 있지만, 웨이퍼에 열이 전달되어 웨이퍼 물질 변경, 본딩의 떨어짐 현상 등이 발생할 수 있다.

셋째, 화학적 디본딩은 특정 화학 용액을 사용하여 접착층을 녹이거나 화학적으로 분해하는 방식이다. 사용되는 화학 물질에 따라 환경 오염 문제가 발생할 수 있으며 화학물질이 웨이퍼에 잔류하거나 손상을 줄 가능성이 존재한다. 넷째, 레이저 디본딩은 레이저를 이용하여 레이어를 분해하거나, 기화시켜 웨이퍼를 분리하는 방식이다. 레이저가 흡수되는 특정물질을 접착층으로 사용한다. 정밀하게 분리가 가능하다. 하지만 레이저 장비 가격이 고가이며, 레이저의 조사면이 작아 분리하는데 시간이 오래걸린다는 단점을 보유하고 있다.

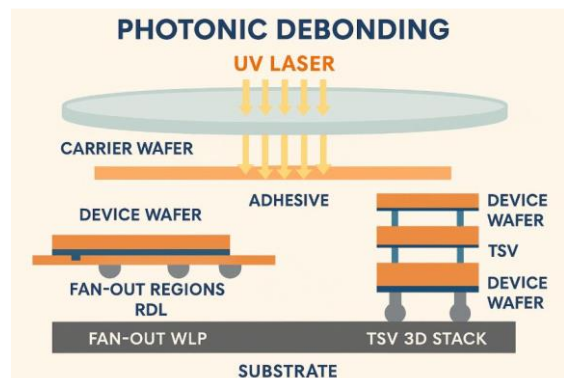
동사가 준비하고 있는 포토닉 디본딩은 고출력 광원(플래시램프)을 이용해 LAL(Light Absorb Layer)에 선택적으로 광을 조사하여 캐리어 웨이퍼를 분리하는 기술이다. 이를 통해 웨이퍼에 물리적·화학적 충격이 발생하지 않아 웨이퍼 손상 및 변형의 위험을 최소화할 수 있다. 불필요한 잔여물 생성을 억제하여 제조 공정의 안정성을 향상시킬 수 있다. 즉, 타 디본딩 방식의 단점을 해결할 수 있는 방식이다.

[그림 1] 레이저 디본딩



자료: 유안타증권 리서치센터

[그림 2] 포토닉 디본딩



자료: 유안타증권 리서치센터

동사는 2024년 8월 미국 펄스포지사와 포토닉 자동화 장비 개발을 위해 전략적 파트너십을 체결했으며, 국내 반도체 제조 공정의 성능을 향상시키고, 비용 절감을 실현하는 포토닉 디본딩 자동화 장비를 개발한다는 목표라고 언급했다. 올해 2월에는 미국 펄스포지사와 협력을 통해 포토닉 디본딩(Photonic Debonding) 자동화 장비를 미국 IDM 업체를 대상으로 출시할 예정이라고 밝혔다. 즉, 국내외 기업과 R&D를 진행하는 것으로 추정된다.

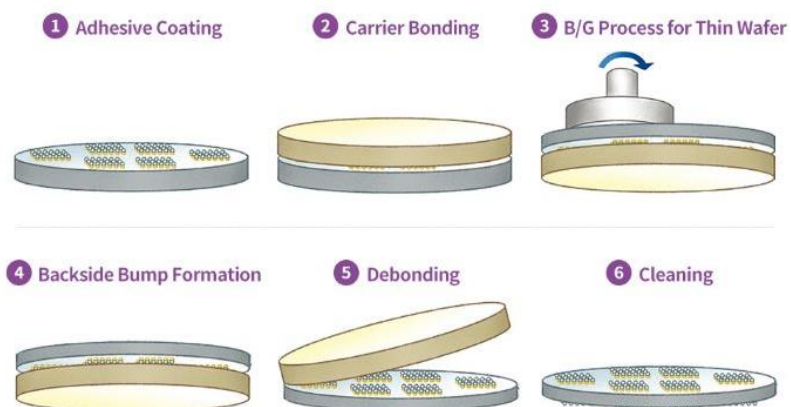
2026년에 납품될 가능성이 높다고 판단한다. 포토닉 디본딩은 공정 및 특성을 감안시 HBM Fab에 적용될 가능성이 높는데, 2026년에 국내외 메모리 반도체 기업들의 신규 Fab이 가동될 예정이기 때문이다. 새로운 장비의 도입은 기존라인 변경보다는 신규라인에 적용하는 것이 합리적이다. 기존 라인 변경시 생산을 중단 & 라인 변경을 진행해야 하는데, 양산 수율이 잡히지 않는 경우 기존 생산마저 포기해야 하는 기회비용이 발생하기 때문이다. 즉, 2H25~1H26내 국내외 기업을 대상으로 포토닉 디본딩 장비에 대한 수주를 받는다면, 신규 Fab에 전체적으로 적용될 가능성이 높다고 판단된다.

포토닉 디본딩은 대기업과의 R&D를 통해서 진행되고 있는 장비, 공동특허를 보유하고 있는 장비가 아니다. 반면, 포토닉 디본딩 장비의 장점을 감안시 메모리 반도체 기업들이 모두 선호할 가능성이 높다. 즉, 고객사 확보를 통한 안정적인 운용이 확인된다면, 고객사 확대에 이어질 가능성이 높다는 것을 의미한다.

동사는 디본딩 장비와 기존 주력장비인 세정장비를 결합하여 판매할 가능성이 높다. 아래 그림에서 확인할 수 있듯이 디본딩 공정 이후에 세정공정이 이어지기 때문이다. 신규 장비라는 점에서 수익성이 기존 장비대비 높을 것으로 예상되며, 결합판매를 통해 반도체 팹 단위당 매출액 규모도 개선될 것으로 기대된다.

이러한 요인들을 기반으로 2H25는 동사의 포토닉 디본딩 장비에 대한 기대감을 높여야 하는 시점이라고 판단한다.

[그림 3] 디본딩 공정



자료: SK 하이닉스, 유안타증권 리서치센터

성장동력2. 산업용 로봇

지난 5월 국내 반도체 제조·모바일·디스플레이 산업 분야 대기업에 모바일 매니플레이터 플랫폼을 활용한 로봇 시스템 수주에 성공했다고 밝혔다. 수주한 로봇 시스템은 동사의 독자적인 모듈러 설계와 경량화된 컨트롤러가 적용된 제품이다. 고객사의 환경에 맞는 자동화 솔루션을 제공할 계획이다.

동사는 로봇 관련 저전압 모터, 드라이버, 모션 알고리즘 기술을 보유하고 있다. 회로 설계부터 펌웨어까지 자체 기술로 구현 가능하다. 소형 모듈러 컨트롤러와 저전압 액추에이터를 적용해 모바일 기기 내부 공간 활용도를 높이고, 공간 최적화와 전력 절감을 통해 효율성과 차별화를 동시에 구현 가능하다. 이러한 기술을 바탕으로 6축 다관절 로봇, 스카라 로봇, 델타로봇 등 다양한 라인업을 보유하고 있다.

동사의 로봇 산업의 시작은 1995년이다. 일본 로봇업체인 산쿄(Sankyo)와의 협업을 통해 국내 로봇 유통사업을 시작으로 로봇 시장에 진출했다. 2019년에는 라이선스를 확보한 후 자체 기술로 개발한 다관절 로봇 제로(ZERO)로 중소형 산업용 로봇 산업에 진출했다. 디스플레이 산업용 로봇 관련 주요 레퍼런스로는 다음과 같다. 2023년 9월, 삼성디스플레이로부터 290억원 규모의 디스플레이 제조공정용 반송로봇 수주를 취득한바 있다. 2024년 7월에는 디스플레이 장비회사인 아바코에 디스플레이 제조공정용 반송로봇 공급계약을 체결했다.

이외에도 표준 수직 다관절 로봇을 통해 대형 가전 해외사업장에 사출 공정 자동화 솔루션을 공급하며, 해외 공장 자동화의 표준화를 목표로 사업을 확장하고 있으며, 2차전지 관련 신규 고객사 확보에도 노력하고 있다. 즉, 다양한 산업으로의 영역을 확장하는 초기시점이다.

동사의 강점은 로봇의 주요 제품인 모터를 자체적으로 보유하고 있으며, FA와 Robot의 결합이 가능하며, 다양한 산업으로의 적용 확대가 가능한 레퍼런스를 보유하고 있다는 점이다. 2024년 기준 산업용로봇 및 진공 사업부에서 1,026억원의 매출액이 발생했다. 공장자동화 및 로봇기업들 중에서 규모면에서 Top Tier급 회사라는 점을 알 수 있다.

[그림 4] 로봇 제품 라인업



자료: 제우스, 유안타증권 리서치센터

성장동력3. PEP

동사는 PEP 개발을 진행하고 있다. 산자부 주관의 정부과제(2023.07~2026.12)이며 과제명은 「고식각을 구현하기 위해 고온(150℃) 공정이 가능한 반도체 희생막 제거용 매엽식 습식 세정장비 및 Chemical 개발」이다.

PEP(Pressurized Etch Process, 가압식 식각공정)는 반도체/디스플레이 공정에서 기존 대기압 조건의 습식 혹은 건식 식각을 특정 압력으로 인위적으로 높여 진행하는 방식을 의미한다. 일반 식각은 대기압 또는 진공 상태에서 플라즈마·화학물질 등을 이용해 웨이퍼 표면의 불필요한 막을 제거하는 공정이다. 환경오염 물질을 절반 이하로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

정부과제 기간 대비 빠른 속도로 진행 중이다. 세미콘코리아 2025(2025.2월)에서 동사는 PEP 세정장비를 이미 공개한 상황이다. 고객사로의 진출을 시도하고 있으며, 2027년 이후에는 가시적인 성과를 기대해 볼 수 있다.

제우스 (079370) 추정재무제표 (K-IFRS 연결)

손익계산서 (단위: 억원)					
결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액	3,600	4,008	5,090	4,029	4,908
매출원가	2,688	2,891	3,711	3,049	3,494
매출총이익	912	1,117	1,379	980	1,413
판매비	730	867	916	909	922
영업이익	182	249	463	71	492
EBITDA	260	365	588	195	610
영업외손익	-8	33	-14	123	86
외환관련손익	-42	39	20	2	84
이자손익	-11	-14	-18	-12	15
관계기업관련손익	0	2	2	2	1
기타	46	6	-18	131	-14
법인세비용차감전순이익	174	282	449	194	577
법인세비용	-7	119	97	94	146
계속사업순이익	181	163	352	100	431
중단사업순이익	0	0	0	0	0
당기순이익	181	163	352	100	431
지배지분순이익	180	160	350	99	419
포괄순이익	174	163	298	74	474
지배지분포괄이익	173	160	297	70	447

주: 영업이익의 산출 기준은 기존 k-GAAP과 동일. 즉, 매출액에서 매출원가와 판매비만 차감

현금흐름표 (단위: 억원)					
결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
영업활동 현금흐름	355	311	81	-392	580
당기순이익	181	163	352	100	431
감가상각비	57	92	100	99	95
외환손익	35	-22	-5	-1	-65
중속, 관계기업관련손익	0	-2	-2	-2	1
자산부채의 증감	116	-20	-460	-550	85
기타현금흐름	-34	101	95	-37	33
투자활동 현금흐름	-514	-125	-143	31	-535
투자자산	2	-54	-73	-105	-471
유형자산 증가 (CAPEX)	-519	-187	-56	-25	-59
유형자산 감소	85	2	32	0	11
기타현금흐름	-81	113	-46	161	-17
재무활동 현금흐름	320	-48	287	259	-68
단기차입금	63	-13	-120	-77	194
사채 및 장기차입금	299	3	417	-156	-154
자본	0	0	0	0	-1
현금배당	-21	-20	-11	-36	-24
기타현금흐름	-21	-18	1	528	-83
연결범위변동 등 기타	-10	0	-32	-5	14
현금의 증감	152	139	193	-107	-10
기초 현금	413	565	704	896	789
기말 현금	565	704	896	789	779
NOPLAT	190	249	463	71	492
FCF	-135	159	71	-380	636

자료: 유안타증권

주: 1. EPS, BPS 및 PER, PBR은 지배주주 기준임
2. PER 등 valuation 지표의 경우, 확정치는 연평균 주가 기준, 전망치는 현재주가 기준임
3. ROE, ROA의 경우, 자본, 자산 항목은 연초, 연말 평균을 기준으로 함

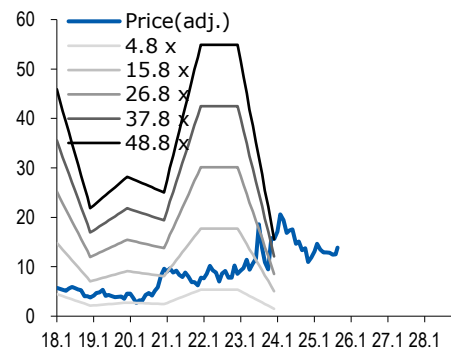
재무상태표 (단위: 억원)					
결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
유동자산	2,442	3,283	4,200	4,276	4,325
현금및현금성자산	565	704	896	789	779
매출채권 및 기타채권	505	632	640	471	621
재고자산	1,090	1,664	2,298	2,671	2,247
비유동자산	1,984	2,014	1,923	1,940	2,084
유형자산	1,493	1,491	1,413	1,342	1,333
관계기업 등 지분관련 자산	11	12	14	16	16
기타투자자산	45	54	59	152	328
자산총계	4,426	5,297	6,123	6,217	6,409
유동부채	1,526	2,267	2,522	2,093	1,954
매입채무 및 기타채무	583	575	480	517	465
단기차입금	630	636	480	393	522
유동성장기부채	124	92	135	95	77
비유동부채	479	527	809	692	632
장기차입금	449	396	760	637	561
사채	0	89	0	0	0
부채총계	2,005	2,794	3,331	2,786	2,586
지배지분	2,368	2,470	2,758	3,044	3,403
자본금	52	52	52	52	155
자본잉여금	375	373	373	592	491
이익잉여금	1,989	2,085	2,426	2,484	2,893
비지배지분	53	33	34	388	420
자본총계	2,421	2,503	2,792	3,431	3,823
순차입금	479	323	329	82	-215
총차입금	1,205	1,220	1,474	1,134	1,170

Valuation 지표 (단위: 원, 배, %)					
결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
EPS	578	513	1,125	320	1,350
BPS	7,667	7,999	8,930	9,813	11,180
EBITDAPS	836	1,171	1,886	627	1,965
SPS	11,557	12,865	16,340	12,966	15,823
DPS	67	33	117	33	100
PER	8.5	16.2	7.7	36.4	11.7
PBR	0.6	1.0	1.0	1.2	1.4
EV/EBITDA	7.9	8.1	5.2	21.0	8.0
PSR	0.4	0.6	0.5	0.9	1.0

재무비율 (단위: 배, %)					
결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액 증가율 (%)	11.3	11.3	27.0	-20.9	21.8
영업이익 증가율 (%)	0.1	36.8	85.8	-84.6	588.2
지배순이익 증가율 (%)	29.1	-11.2	119.2	-71.6	321.0
매출총이익률 (%)	25.3	27.9	27.1	24.3	28.8
영업이익률 (%)	5.1	6.2	9.1	1.8	10.0
지배순이익률 (%)	5.0	4.0	6.9	2.5	8.5
EBITDA 마진 (%)	7.2	9.1	11.5	4.8	12.4
ROIC	7.7	10.0	17.9	2.5	16.3
ROA	4.4	3.3	6.1	1.6	6.6
ROE	7.8	6.6	13.4	3.4	13.0
부채비율 (%)	82.8	111.6	119.3	81.2	67.6
순차입금/자기자본 (%)	19.8	12.9	11.8	2.4	-5.6
영업이익/금융비용 (배)	10.5	10.4	13.9	2.0	15.7

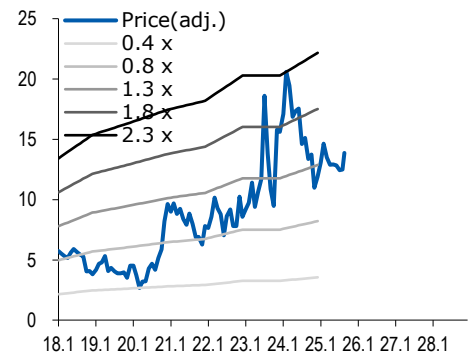
P/E band chart

(천원)

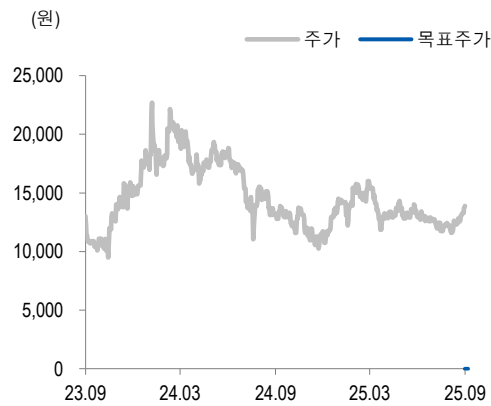


P/B band chart

(천원)



제주스 (079370) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율 평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2025-09-17	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"

2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	93
Hold(중립)	7
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2025-09-17

※ 해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자 : 권명준)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.